

中国工程院

2014 新材料国际发展趋势高层论坛

第二轮通知

“2014 新材料国际发展趋势高层论坛”定于 2014 年 9 月 19-21 日在古城西安市举行,论坛邀请了 40 余位国内外知名华人材料科学家在超导材料、复合材料、凝固技术、光催化材料、3D 打印、材料计算等先进材料与工程领域报告世界前沿动态。论坛召开同期还将举办“3D 打印材料技术前沿论坛”、“复合材料技术前沿论坛”和“材料基因组计划研究进展论坛”。热忱欢迎各高校、科研院所、企事业单位等专家、学者出席论坛。

一、组织机构

主办单位: 中国工程院化工、冶金与材料工程学部
中国材料研究学会
新材料学术联盟

承办单位: 西北工业大学
西安市高新技术产业开发区
西北有色金属研究院

协办单位: 《中国材料进展》杂志社
凝固技术国家重点实验室

支持单位: 中国工程院
国家自然科学基金委
国家科学技术部基础司
国家科学技术部高新司
国家发展和改革委员会高技术产业司

顾 问： 师昌绪、李恒德、严东生
主 席： 周 廉、干 勇、黄伯云、
执行主席： 魏炳波、赵红专、韩雅芳、张平祥
秘 书 长： 李贺军、左家和、毋录建、贾豫冬
副秘书长： 董文强、李金山、朱宏康、王 方

二、会议地点及日程

陕西宾馆，西安市丈八路。

时 间	上午	下午
9月19日	报 到	
9月20日	开幕式 大会报告	大会报告
9月21日	大会报告	3D打印材料技术前沿论坛 复合材料技术前沿论坛 材料基因组论坛通知
9月22日	离 会	

三、注册

注册费：正式代表 1800 元；学生代表 900 元；会议期间食宿统一安排，费用自理。

交费方式： 1.现场缴费； 2.汇款：

户 名：《中国材料进展》杂志社

开户行：中国工商银行股份有限公司西安未央支行

账 号：3700 0236 0920 0131 322

电 话：029-86226599 传真：029-86282362 联系人：高虹

四、会议联系方式

联系人：杨妮花 王 方

电 话：029-88492642、029-86226599

手 机：（13572585118、13991338060）

传 真： 029-88492642 029-86282362

E-mail: yangnihua@nwpu.edu.cn materialschina@163.com、

地 点： 西安市友谊西路127号西北工业大学材料学院

更加详细内容请访问会议网址: <http://www.mat-china.com/>

中国工程院化工、冶金与材料工程学部

2014年8月8日



参会回执

姓 名		电话/手机	
单 位			
E-mail		传 真	
是否住宿	<input type="checkbox"/> 单人间 <input type="checkbox"/> 双人间	接、送站信息 (航班、高铁)	
备 注	本次会议安排酒店为绿地假日酒店，标准间/大床房价格为500元含早。 丈八宾馆18号楼，价格为580元含早，丈八宾馆12号楼价格为400元含早		

请您于9月5日前填写回执，发送传真至：029-88492642 或 E-mail 至

yangnihua@nwpu.edu.cn 杨妮花收。